

ACP 158H 各向异性导电胶 产品技术数据表

优异的热循环性能
卓越的电导性能
高良率

简介

ACP 158H 是一种各向异性导电胶, 适用于 芯片级封装、球栅阵列封装、封装叠封、栅格阵列封装, 以及部分倒装芯片, 应用。同时, 该材料也适用于多种先进封装中的裸芯片保护, 包括存储卡、芯片载体、混合电路及多芯片模块等。ACP 158H 专为 高温无铅焊料(如 SnAgCu、SnAg 等) 热压焊接工艺 设计。该材料点胶性能优异, 可有效降低封装过程中产生的应力, 并提供卓越的可靠性表现(如温度循环性能)和优异的机械强度。在完成热压互连及固化后, ACP 158H 形成的互连结构在可靠性方面可媲美传统焊点, 为高密度互连及器件微型化提供可靠解决方案。

物理特性

产品名称	ACP 158H 导电胶
外貌	可焊接銀
未固化材料性能	
專案	數值
比重 (ASTM D 1475-60)	1.8 – 2.2 g/cc
粘度(Brookfield, 0.5 rpm)	5 – 8.0 kcP
固化后材料性能	
玻璃化转变温度 (Tg) Via TMA (ASTM D3418-82)	149 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha_1 = 30$; $\alpha_2 = 135$
剪切强度(FR4/FR4)	2600 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm

推荐固化条件

热压焊接温度: 260 – 280 °C

保温时间: 约 30 秒

注: 5–10 分钟的固化时间包含胶层达到目标固化温度所需的升温时间。可根据实际工艺需求评估其他替代固化曲线。

储存与保质期

在 –40 °C 条件下、并保持原始密封包装保存时, 材料的保质期为 6 个月。超过该期限储存, 材料粘度可能会升高。请注意防止受潮、挥发以及异物污染, 否则可能对产品的加工性能产生不利影响。

安全信息

ACP 158H 为环保型、无毒材料。但在使用和操作过程中, 仍建议遵循一般工业卫生规范。有关详细的安全与操作信息, 请参阅本产品的 安全数据表。

包装规格

ACP 158H 毛细管底部填充系列产品提供 10 cc 和 30 cc 两种规格。其他包装规格可依客户需求提供。如需订购信息, 请联系 YINCAE 公司。